

PCB	产品名称	产品型号	版本	页数	制订时间
焊接工艺要求	交流伺服	ISED-E15F1 焊接要求	V7	1	2022-11-3
<p>1. 参照“ISED-E15FX-V7”文件；</p> <p>2. 红色序号的元件有焊接高度要求</p> <p style="padding-left: 20px;">D14 的管脚高出线路板 8mm 整，并要横平竖直；</p> <p style="padding-left: 20px;">Q2 的管脚高出线路板 7mm 整，并要横平竖直；</p> <p style="padding-left: 20px;">R83、R105 圆体底部高出线路板 2~3mm；</p> <p>3. 焊接 U1 时要保证 U1 的<u>上平面</u> 平行于线路板，U1 的管脚本身有自然的卡点，卡点紧贴线路板；</p> <p>4. 电容 C2 为直插件，焊接前需成型，电容躺平在线路板上；</p> <p>5. 所有焊盘（焊锡）的高度、管脚的高度，均不能超过 2mm，超出一个点，则为不合格品；</p> <p>6. J5 及显示板的焊接，参照文件《ISED-F 显示板焊接的方法》；</p> <p>7. 未标注的元件，紧贴线路板焊接；</p> <p>8. 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准</p>					
编制		审核		批准	
日期		日期		日期	